2026 年 11 月 24 日

NEWS RELEASE

キヤノン株式会社

ArF ドライ半導体露光装置の新製品を 24 年ぶりに市場投入
ラインアップを拡充し多様化する半導体製造に貢献

キヤノンは、2026 年 12 月上旬に、ArF※1 ドライスキャナー“FPA-6300AS6”の受注を開始します。本製品の投入により、i 線、KrF※2、ArF の各半導体露光装置およびナノインプリント半導体製造装置を含む、前工程向けのラインアップを拡充し、多様な半導体製造のニーズに対応します。



FPA-6300AS6

近年、デバイスごとに求められる性能や用途が多様化する中、半導体露光装置には、微細な回路形成に加え、さまざまな基板仕様や製造要件への対応が求められています。

新製品は、キヤノンが 24 年ぶり※3 に市場投入する ArF ドライ半導体露光装置です。高い生産性と安定した性能で実績のある KrF 半導体露光装置「FPA-6300ES6a」（2012 年 4 月発売）のプラットフォームを継承し、新開発の NA（開口数）0.93 の投影レンズを採用しています。メモリー需要に加え、パワーデバイスやセンサーなどの微細化に対応するほか、小径基板や薄・厚基板、裏面アライメントを用いる製造プロセスなど、多様な半導体製造ニーズに応えます。

さらに、半導体露光装置向けソリューションプラットフォーム「Lithography Plus」（2022 年 9 月発売）との連携も可能です。これまでに蓄積したノウハウやデータを統合的に活用することで、サポート業務を効率化するとともに、装置の稼働率を高め、生産性向上に寄与します。

本製品の投入により、キヤノンは i 線、KrF、ArF の各半導体露光装置およびナノインプリント半導体製造装置を含む前工程向け製品ラインアップを拡充します。多様化する半導体製造ニーズに幅広く対応するとともに、今後も半導体製造装置の開発を通じて、半導体産業の発展と顧客の生産性向上に貢献していきます。

なお、本製品は、2026 年 12 月 9 日（水）から 11 日（金）に東京ビッグサイトで開催される「SEMICON Japan 2026」でパネル展示します。

〈製品仕様について〉

製品仕様の詳細はキヤノンホームページをご参照ください。
https://global.canon/ja/product/indtech/semicon/fpa6300as6.html

※1　フッ化アルゴン。露光波長は 193nm。
※2　フッ化クリプトン。露光波長は 248nm。
※3　「FPA-6000AS4」（2002 年 7 月受注開始）以来。

● 一般の方のお問合せ先　：キヤノン株式会社　光機営業統括センター　03-5732-8776（直通）